

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# TRULY®

## 信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

### 須予披露交易

#### 貸款協議

茲提述日期為二零一三年十二月十七日及二零一四年十一月十一日之公告，內容有關成立合資公司及其後增資。

#### 貸款協議

於二零一五年八月十九日，信利半導體與合資公司訂立貸款協議，據此，信利半導體同意向合資公司提供貸款，由首次提取日期起為期六個月，以為合資公司興建AMOLED產品之生產線提供資金。

#### 上市規則之涵義

由於合資公司並非本公司之附屬公司，貸款安排項下交易構成上市規則第14章項下之財務援助。

由於(1)貸款協議由訂約方於二零一五年八月十九日(增資協議簽訂日期起計十二個月內)訂立；及(2)貸款協議及增資協議共同導致本公司大幅參與AMOLED技術相關業務(有關業務過往並非本公司主要業務之一部分)，故貸款協議及增資協議項下交易合併計算。

由於貸款協議及增資協議項下交易之若干適用百分比率合計超過5%但少於25%，故根據上市規則，貸款協議項下交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告規定。

茲提述日期為二零一三年十二月十七日及二零一四年十一月十一日之公告，內容有關成立合資公司及其後增資。

於二零一五年八月十九日，信利半導體與合資公司訂立貸款協議，據此，信利半導體同意向合資公司提供貸款，由首次提取日期起為期六個月，以為合資公司興建AMOLED產品之生產線提供資金。

## 貸款協議

日期	二零一五年八月十九日
貸方	信利半導體
借方	合資公司
貸款	人民幣500,000,000元
年期	於貸款協議簽訂日期後一個月內首次提取日期起為期六個月。信利半導體須於貸款協議簽訂日期後一個月內以單一或多次提取方式將貸款存入合資公司賬戶。
利率	年息4.85厘
還款	合資公司須於到期日向信利半導體償還本金連同利息。 取得信利半導體同意後，合資公司可於到期日前償還本金及實際產生之利息。

## 訂立貸款安排之理由及裨益

本公司認為，AMOLED很可能成為下一代主流顯示技術。根據貸款協議提供貸款將讓合資公司得以及時增加營運資金，藉以興建AMOLED產品之生產線及促進本公司有關新一代顯示技術之策略目標。

因此，董事會認為，訂立貸款協議符合本集團利益。董事(包括獨立非執行董事)認為，貸款協議乃按一般商業條款訂立，而貸款協議之條款屬公平合理，且符合股東整體利益。

由於概無董事於貸款協議中擁有重大權益，概無董事須就批准貸款協議之相關董事會決議案放棄表決。

預期合資公司可能與商業銀行訂立貸款協議以進一步為興建AMOLED產品之生產線融資，而本公司亦可能就此提供擔保。合資公司一旦自商業銀行取得貸款，合資公司將動用部分銀行貸款償還貸款。於本公告日期，合資公司仍與商業銀行就進一步融資進行磋商，惟未有訂立任何正式協議。本公司將遵守上市規則，並於適當時候或按照上市規則之規定就向合資公司提供額外財務援助另行作出公告。

## 有關本集團之資料

本集團主要從事製造及銷售液晶顯示器產品(包括觸控屏產品)及電子消費產品，包括微型攝像模組、個人保健護理產品及電子設備。

## 有關合資公司之資料

合資公司主要從事開發及生產AMOLED顯示產品。於本公告日期，合資公司分別由信利半導體、惠州仲愷及惠州投資持有53.00%、24.5%及22.5%權益。

惠州仲愷乃由惠州管理委員會全資擁有之國有企業，主要從事投資業務。

惠州投資乃由惠州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有之國有企業，主要從事投資業務。

就董事經作出一切合理查詢後所深知及全悉，惠州仲愷及惠州投資以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 上市規則之涵義

由於合資公司並非本公司之附屬公司，貸款安排項下交易構成上市規則第14章項下之財務援助。

由於(1)貸款協議由訂約方於二零一五年八月十九日(增資協議簽訂日期起計十二個月內)訂立；及(2)貸款協議及增資協議共同導致本公司大幅參與AMOLED技術相關業務(有關業務過往並非本公司主要業務之一部分)，故貸款協議及增資協議項下交易合併計算。

由於貸款協議及增資協議項下交易之若干適用百分比率合計超過5%但少於25%，故根據上市規則，貸款協議項下交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AMOLED」	指	有源矩陣有機發光二極管，一種半導體產品
「董事會」	指	董事會
「增資協議」	指	信利半導體與惠州仲愷及惠州投資就向合資公司增資所訂立日期為二零一四年十一月十一日之增資協議
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	信利國際有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「惠州投資」	指	惠州市投資控股有限公司，於中國註冊成立之公司，由惠州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有
「惠州管理委員會」	指	惠州仲愷高新技術產業開發區管理委員會，惠州仲愷之唯一股東
「惠州仲愷」	指	惠州仲愷高新區投資開發有限責任公司，於中國註冊成立之公司，由惠州管理委員會全資擁有

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士之人士或公司
「合資公司」或「借方」	指	根據日期為二零一三年十二月十七日之股東協議由訂約方於中國共同成立之有限責任公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「貸款」	指	本集團根據貸款協議借貸予合資公司為數人民幣500,000,000元之款項
「貸款協議」	指	信利半導體與合資公司各自就貸款所訂立日期為二零一五年八月十九日之貸款協議
「貸款安排」	指	貸款協議項下擬進行有關信利半導體向合資公司提供貸款之安排
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司不時之股份持有人
「附屬公司」	指	具公司條例第15條所賦予之涵義
「信利半導體」或「貸方」	指	信利半導體有限公司，於中國註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
信利國際有限公司  
主席  
林偉華

香港，二零一五年八月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張達生先生；非執行董事李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。